

天津中环半导体股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2021 年 1 月 21 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于授权经营层 2021 年度向银行申请综合授信的议案》

授权经营层在 2021 年度向银行申请综合授信，总额度不超过 45 亿元人民币，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。

上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司董事会授权公司经营层根据公司的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以公司与银行签订的有关合同为准。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-003）。

表决票 9 票，赞成票 9，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日